

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-05

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（_____）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	<p>安信证券、财通证券、财通证券资管、东北证券、东方财富证券、第一创业证券、东方财富证券、东海证券、东证融汇证券资管、东兴证券、德邦证券、方正证券、广发证券、国海证券、国金证券、国联证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华创证券、华福证券、华金证券、华融证券、华泰证券、华泰证券（上海）资管、华西证券、华兴证券、汇丰前海证券、开源证券、民生证券、平安证券、山西证券、上海东方财富证券资管、上海光大证券资管、上海申银万国证券、太平洋证券、天风证券、天风证券资管、信达证券、西部证券、西南证券、湘财证券、兴业证券、高盛、摩根大通、瑞士银行、花旗环球金融亚洲有限公司、野村国际（香港）、摩根士丹利基金、摩根证券投资信托、建银国际证券、长城证券、长江证券资管、招商证券、招商证券资管、招银国际证券、浙商证券资管、浙商证券、中金公司、中国银河证券、中泰证券、中泰证券（上海）资管、中天证券、中信建投证券、中信证券、中银国际证券、中邮证券、长盛基金、富安达基金、博泽资产、新加坡政府投资公司 GIC、开域资本（新加坡）、深圳市远信投资、上海十溢投资、众志汇通资产、中融鼎（深圳）投资、臻一资产、浙江秘银投资、浙江黑岩投资、张家港高竹私募基金、粤民投私募证券基金、永安国富资产、银润资产、玄元私募基金、兴银理财、兴业银行、西藏源乘投资、微明恒远投资、天时（天津）股权投资基金、君榕资产、盛钧私募基金、盛博香港有限公司、昭图投资、鑫然投资、中欧瑞博投资、中才中环投资、前海登程资产、惠通基金、旭鑫资产、深圳富博领航私募证券投资基金、深圳丞毅投资、上海重阳投资、上海韞然投资、上海远策投资管理中心（有限合伙）、上海域秀资产、上海瀛赐私募基金、懿坤资产、汐泰投资、世诚投资、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）、上海钦沐资产管理合伙企业（有限合伙）、上海磐行企业管理有限公司、上海盘京投资管理中心（有限合伙）、上海弥加投资管理中心（有限合伙）、上海聆泽投资管理有限公司、利幄私募基金、聚鸣投资、玖鹏资产、景领投资、泾溪投资、金犇投资、灏霁投资、泮谊投资、非马投资、从容投资、翀云私募基金、乘安资产、博笃投资、睿思资本、群益投信、全天候私募证券基金、青岛朋元资产、南方天辰（北京）投资、湖南万泰华瑞投资、鸿运私募基金、浩成资产、昊泽致远（北京）投资、杭州萧山泽泉投资、杭州乐信投资、杭银理财、瀚川投资、海南鸿盛私募基金、海创（上海）私募基金、国新投资、国经资本、国新国证基金、国改双百发展基金、里思私募证券投资基金、瑞民私募证券投资基金、熵简私募基金、润达私募基金、沅京资本、丰琰投资、敦和资产、淡水泉、泓澄投资、百川财富、Point72、IMR Partners、LIBRARY GROUP、红杉资本、博时基金、才华资本、财通基金、创金合信基金、大成基金、德邦基金、东方阿尔法基金、东兴基金、富国基金、工银瑞信基金、光大保德信基金、广发基金、国融</p>

	基金、国泰基金、海富通基金、国华人寿保险、和谐健康保险、昆仑健康保险、中华联合保险集团、中国人保资产、红土创新基金、华富基金、华夏基金、汇百川基金、汇泉基金、汇添富基金、嘉合基金、嘉实基金、建信基金、交银施罗德基金、九泰基金、路博迈基金（中国）有限公司、马可孛罗至真资管、民生加银基金、南方基金、鹏华基金、鹏扬基金、融通基金、睿远基金、申万菱信基金、深圳华强资产管理集团、太平基金、泰康基金、泰康资管、天弘基金、万家基金、西部利得基金、西藏东财基金、新华基金、兴合基金、兴业基金、兴证全球基金、亚太财产保险、易方达基金、永赢基金、圆信永丰基金、长安基金、长江养老保险、长信基金、招商基金、中金基金、中信保诚基金、中欧基金、朱雀基金、鲍尔赛嘉(上海)投资、大家资产、佛山市东盈投资、博众智能科技投资、国泰租赁、红骅投资、华安财保资管、华夏久盈资管、建信保险资产、建信养老金、立格资本、普徠仕香港有限公司、乘是资产、牛乎资产、拓聚投资、泽娴投资、中汇金投资、鑫巢资本、太平资产、无锡信能投资、新华资管、永诚保险资管、长城财富保险资管、招商信诺资管、源乐晟、光大永明、平安养老、千禧基金、银华基金、国寿资产
时间	2024年3月15日—3月17日
地点	电话及网络会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君；战略发展部总监、证券事务代表：谢丹； 投资者关系经理：郭家旭
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>介绍公司 2023 年度经营业绩情况、问答交流。</p> <p>一、公司 2023 年度经营业绩情况简要介绍</p> <p>2023 年，全球宏观形势复杂多变，电子产业受宏观经济下行叠加下游企业去库存影响，整体需求承压；同时，公司坚持面向未来，对高阶封装基板等高端领域保持坚定的战略投入。在此背景下，报告期内公司实现营业总收入 135.26 亿元，同比下降 3.33%；归属于上市公司股东的净利润 13.98 亿元，同比下降 14.81%。上述变动主要由于下游市场需求下行，封装基板和 PCB 业务全年整体稼动率较上年同期有所下降，叠加封装基板新项目建设、新工厂爬坡等带来的费用和固定成本增加等因素影响。</p> <p>主营业务层面，报告期内公司 PCB 业务实现主营业务收入 80.73 亿元，同比下降 8.52%，占公司营业总收入的 59.68%，业务毛利率 26.55%，同比下降 1.57 个百分点；封装基板业务实现主营业务收入 23.06 亿元，同比下降 8.47%，占公司营业总收入的 17.05%，业务毛利率 23.87%，同比下降 3.11 个百分点；电子装联业务实现主营业务收入 21.19 亿元，同比增长 21.50%，占公司营业总收入的 15.67%，业务毛利率 14.66%，同比增加 1.51 个百分点。</p>

二、主要交流内容

Q1、请介绍公司 2023 年下半年营业收入及毛利率的环比变化情况。

2023 年下半年，公司把握行业需求的局部修复机会，盈利能力环比有所改善。公司在 2023 年下半年实现营业收入 74.93 亿元，环比增长 24.2%，归母净利润 9.24 亿元，环比增长 95%，扣非归母净利润 5.72 亿元，环比增长 34.4%。上述变动主要得益于公司把握封装基板及 PCB 业务下游部分需求恢复的机会，整体稼动率较上半年有所提升，营收规模环比有所增长；同时，公司内部精益改善工作持续开展，运营能力获得进一步提升，助益毛利率环比增长。此外，公司在本期内收到部分政府补助款项，助益归母净利润环比增长。

Q2、请介绍公司 PCB 业务 2023 年各主要下游领域经营拓展情况。

2023 年，PCB 业务通信领域订单整体规模同比有所下降，主要由于国内通信市场需求未出现明显改善，海外市场下半年以来项目节奏有所放缓，导致相关需求后延。公司主动优化产品结构，结合一系列成本优化举措，降低通信市场需求弱化带来的影响。海外项目开发及产品导入工作取得进展，公司在海外客户处的订单份额保持稳定。

PCB 业务数据中心领域报告期内订单整体同比微幅增长，主要由于在全球服务器市场 2023 年整体需求下滑的背景下，下半年以来公司部分客户 Eagle Stream 平台产品逐步起量，叠加在新客户及部分新产品（如 AI 加速卡等）开发上取得一定突破。

PCB 业务汽车领域报告期内订单整体同比增长超 50%，主要得益于公司充分把握汽车电子在新能源和 ADAS 方向的增长机会，前期导入的新客户定点项目需求释放，以及 ADAS 相关高端产品的需求上量。南通三期工厂顺利爬坡为订单导入提供产能支撑。此外，海外 Tier 1 客户开发工作进展顺利，为未来汽车业务的持续发展奠定基础。

此外，工控医疗、能源等其他领域 2023 年规模占 PCB 业务比重相对较小。公司将继续优化下游市场产品结构，增强市场拓展能力。

Q3、请介绍公司封装基板业务 2023 年在下游市场拓展情况。

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2023 年

上半年全球半导体行业景气较弱，下游客户产品库存调整周期拉长，下半年以来部分领域需求有所修复。公司封装基板业务通过深耕存量市场、开发新客户等多措并举，保障业务营收的基本稳定。公司凭借广泛的 BT 类基板产品覆盖能力与针对性的销售策略把握需求回暖机遇，其中存储与射频产品受益于客户开发突破与下半年存量客户需求修复，均实现了订单同比增长。FC-BGA 封装基板部分产品已完成送样认证，处于产线验证导入阶段。

另一方面，无锡二期基板工厂持续推进能力提升与量产爬坡，加速客户认证和产品导入进程。广州封装基板项目一期建设推进顺利，已于 2023 年第四季度完成连线投产，目前已开始产能爬坡。无锡二期基板工厂爬坡和广州封装基板项目建设带来的成本和费用增加对公司报告期内利润造成一定负向影响。公司将继续推进封装基板业务战略目标客户开发与关键项目落地，推动无锡二期基板工厂实现盈利、加快 FC-BGA 产品线竞争力建设，支撑广州封装基板项目顺利爬坡。

Q4、请介绍公司封装基板业务在技术能力方面取得的突破。

公司作为目前内资最大的封装基板供应商，具备包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力，在部分细分市场拥有领先的竞争优势。2023 年，公司 FC-CSP 封装基板产品在 MSAP 和 ETS 工艺的样品能力已达到行业内领先水平，RF 封装基板产品成功导入部分高阶产品。

另一方面，针对 FC-BGA 封装基板产品，14 层及以下产品公司现已具备批量生产能力，14 层以上产品具备样品制造能力。公司在高阶领域新产品开发过程中仍将面临一系列技术研发挑战，后续将进一步加快技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。

Q5、请介绍公司电子装联业务 2023 年在下游市场拓展情况。

公司电子装联产品按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、数据中心、医疗电子、汽车电子等领域。2023 年，公司通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性，并持续加强内部运营及供应链管理，在营收和毛利率层面均实现提升。公司将继续以数据中心、汽车等市场领域为重点，并持续深耕通信、工控、医疗等领域。

	<p>Q6、请介绍公司研发投入同比增长的原因。</p> <p>报告期内，公司研发投入 10.73 亿元，金额同比增长 30.94%，占营收比重为 7.93%，占比同比提升 2.07 个百分点。研发投入增长主要受 FC-BGA 封装基板平台能力建设等项目影响。</p> <p>Q7、请介绍公司近期工厂稼动率变化情况。</p> <p>近期公司 PCB 及封装基板业务稼动率较 2023 年第四季度均有所提升。</p> <p>Q8、请介绍当前 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。</p> <p>伴随 AI 的加速演进和应用上的不断深化，ICT 产业对于高算力和高速网络的需求日益紧迫，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速交换与传输的需求迎来增长。上述趋势驱动了终端电子设备对高频高速、集成化、小型化、轻薄化、高散热等相关 PCB 产品需求的提升。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求将受到上述趋势的影响。</p> <p>Q9、请介绍公司投资建设泰国工厂的业务定位及当前进展。</p> <p>公司在泰国投资建设的工厂主要涉及 PCB 产品制造及销售，目前仍处于规划阶段，后续尚需履行国内境外投资备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。建设泰国工厂的举措有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户需求，完善产品在全球市场的供应能力。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 3 月 17 日